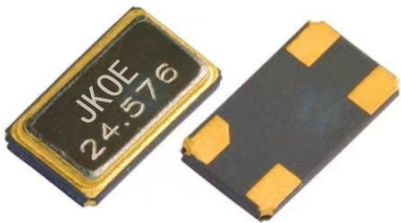


X63F



产品特点及应用范围:

- 体积小
 - 准确度高
 - 陶瓷封装
 - 盘带包装
 - 可回流焊接
- 工业控制
 - 仪器仪表
 - 汽车电子
 - 军用设备

产品性能

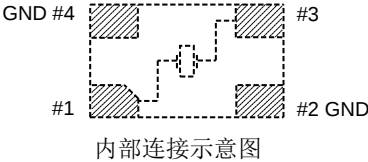
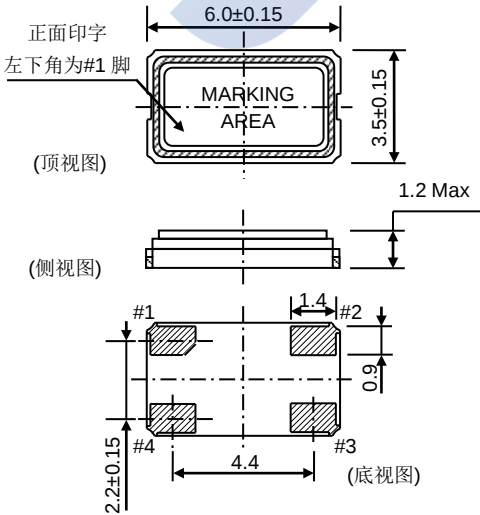
性能参数		X63F	
频率范围 (MHz)	F ₀	8.000~50.000	27.000~100.000
振动模式	Mode	AT 基频	3 次泛音
串联谐振电阻 (Ω)	R _r	见等效电阻对照表	
频率精度 (25°C 时)	F _{tol}	±5×10 ⁻⁶ ~±30×10 ⁻⁶	
储存温度范围	T _{stg}	-55°C~+125°C	
静电容	C ₀	7pF Max.	
负载电容	CL	10pF~30pF 或串联	
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V	
激励功率	DL	0.01mW~0.1mW	
老化率	F _{age}	±5×10 ⁻⁶ /年 Max.	

频率温度稳定度选型表

工作温度范围	频率稳定度					
	O:±10×10 ⁻⁶	P:±15×10 ⁻⁶	Q:±20×10 ⁻⁶	S:±30×10 ⁻⁶	T:±50×10 ⁻⁶	U:±100×10 ⁻⁶
B: -10°C ~ +60°C	●	●	●	●	●	●
C: -20°C ~ +70°C	●	●	●	●	●	●
ΔG: -40°C ~ +85°C			●	●	●	●
▽Q: -40°C ~ +125°C					◎	◎

●: 可选产品 ◎: 定制产品 Δ: 工业级 ▽: 汽车级

外形尺寸(mm)



引脚	功能
#1	输入
#2	接地
#3	输出
#4	接地